

第6回 KISTEC Innovation Hub 2023

次世代電子実装システム技術講演会

11/17

金

14:40 - 17:10

定員 100名(来所)

対象 300名(オンライン)

当該テーマに関心のある方は
どなたでもご参加いただけます

本講演会では、次世代半導体の開発を目的とした次世代電子実装システム技術研究会の取り組みと脱炭素化に向けて、超低消費電力の電子デバイス材料や環境負荷の小さい「負」熱膨張材料(温めると縮む性質を持つ材料)の開発、デジタル画像相関法(DIC)による熱サイクル試験のひずみ測定法およびサンプリングモアレ法を用いたアンダーフィル材料の内部ひずみ測定について紹介します。

14:40-14:45

オープニング

14:45-15:15 負熱膨張材料、超低消費電力磁気メモリ

先脱炭素化に向けて、超低消費電力の電子デバイス材料や環境負荷の小さい「負」熱膨張材料(温めると縮む性質を持つ材料)の開発について紹介する。

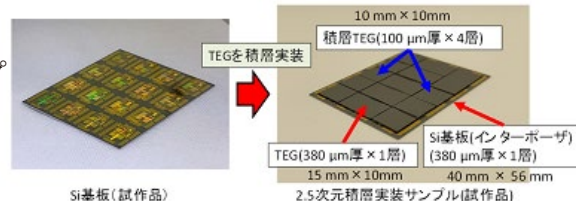
講師：東 正樹 教授

国立大学法人 東京工業大学
科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所

15:15-15:35 次世代電子実装システム技術研究会の取り組み

2.5次元積層半導体の開発を目的とした次世代電子実装システム技術研究会の取り組みについて紹介します。

講師：根本 俊介

KISTEC
電子技術部 電子デバイスグループ

15:35-16:05 Measurement of Thermal Strain of Metallized Silicon Nitride Substrate in Thermal Cycling Test by Digital Image Correlation Method

デジタル画像相関法(DIC)による熱サイクル試験のSilicon Nitride基板のひずみ測定法について紹介する。

講師：Ngo Minh Chu 氏

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
中部センター マルチマテリアル研究部門 セラミックス組織制御グループ

16:05-16:35 サンプリングモアレ法を用いたアンダーフィル材料の内部ひずみ測定

サンプリングモアレ法を用いたアンダーフィル材料の内部ひずみ測定法をご紹介します。

講師：吉田 拓弥 氏

ナミックス株式会社
技術開発本部開発U 評価技術開発G シミュレーションT

16:35-16:40

エンディング 青柳 昌宏 卓越教授 熊本大学
半導体・デジタル研究機構半導体部門
KISTEC Innovation Hub2023

参加申し込みは、右隣記載のQRコードをクリック。
または、読み込んで頂きホームページからご登録ください。
申込締め切りは11/5(日)。
ご不明な方はお問い合わせにご連絡ください。

<https://www.kistec.jp/inno-hub/e17-3/>

お問い合わせ：電子技術部 電子デバイスグループ 根本俊介 E-mail: sm-electronic_devices_g@kistec.jp

主催：地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)